

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform A,
Art. Nr. 244-11000-15

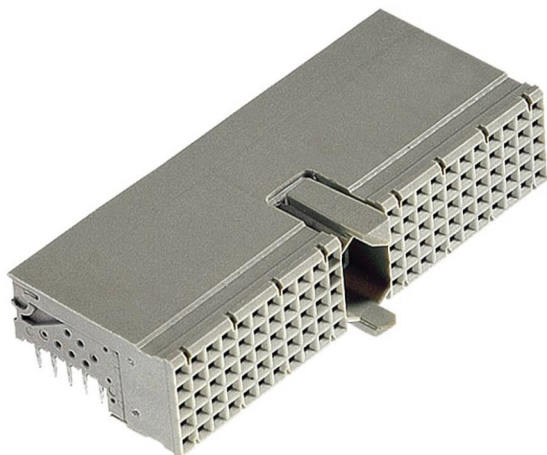


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- Polzahl 110
- Anschlusslänge 2.9 mm
- für min 1.44 mm Leiterplattendicke
- ohne Schirmung
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe hm 2.0

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform A,
Art. Nr. 244-11000-15



Technische Daten

Grundlagen

| | |
|--------------------|------------------|
| Spezifikation | IEC 61076-4-101 |
| Gütestufe | 2 |
| Anzahl Kontakte | 110 |
| Anschlusstechnik | Einpresstechnik |
| Anschlusslänge | 2.9 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |

Material

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
| CTI Wert <i>IEC 60112</i> | 200 |
| Kontaktmaterial | Bronze |

Mechanisch

| | |
|------------------------|--|
| Rastermaß | 2.0 mm |
| Steckkraft pro Kontakt | Kontakt: max. 0.75 N, Abschirmung: max. 1 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | Kontakt: min. 0.15 N, Abschirmung: min. 0.15 N |
| Lebensdauer | > 250 Steckzyklen |

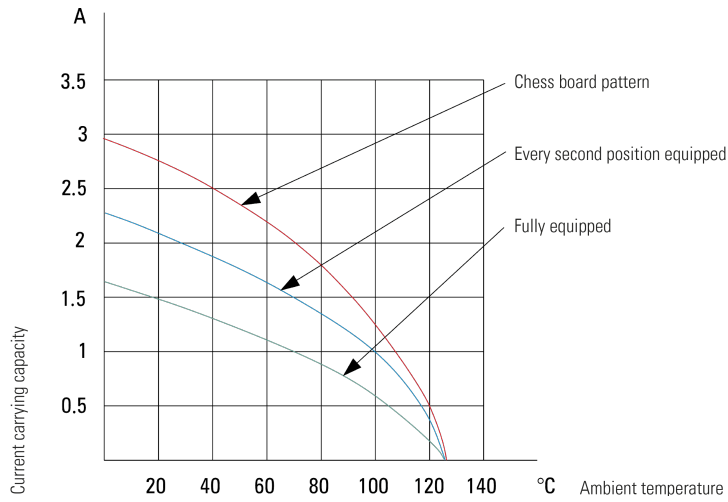
Elektrisch

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Betriebsstrom | 1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C |
| Durchgangswiderstand | max. 20 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥ 0.6 mm |
| Isolationswiderstand | min. 10 ⁴ MΩ |
| Prüfspannung | 750 V r.m.s |
| Datenübertragung | 3.125 Gbit/s |

Zulassungen / Konformität

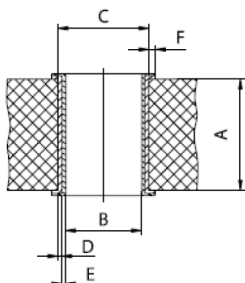
| | |
|---------|--------------|
| UL file | E130314 |
| Umwelt | RoHS konform |

Derating Diagramm



Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



| Material | chem. Sn Schicht |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|-----------------------------|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | rein Cu Leiterplatten |
|-----------------------------|---|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP*,z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|----------------------|
| Nennloch | Ø 0.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 0.60 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.70 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform A,
Art. Nr. 244-11000-15



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Kontaktbeschichtung
- Auch in THTR Technik

Zubehör

» hm2.0 Kodiereinsatz Federleiste
Artikelnummer 244-8031

» hm2.0 Kodiereinsatz Federleiste
Artikelnummer 244-8014

» hm2.0 Kodiereinsatz Federleiste
Artikelnummer 244-8012

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)